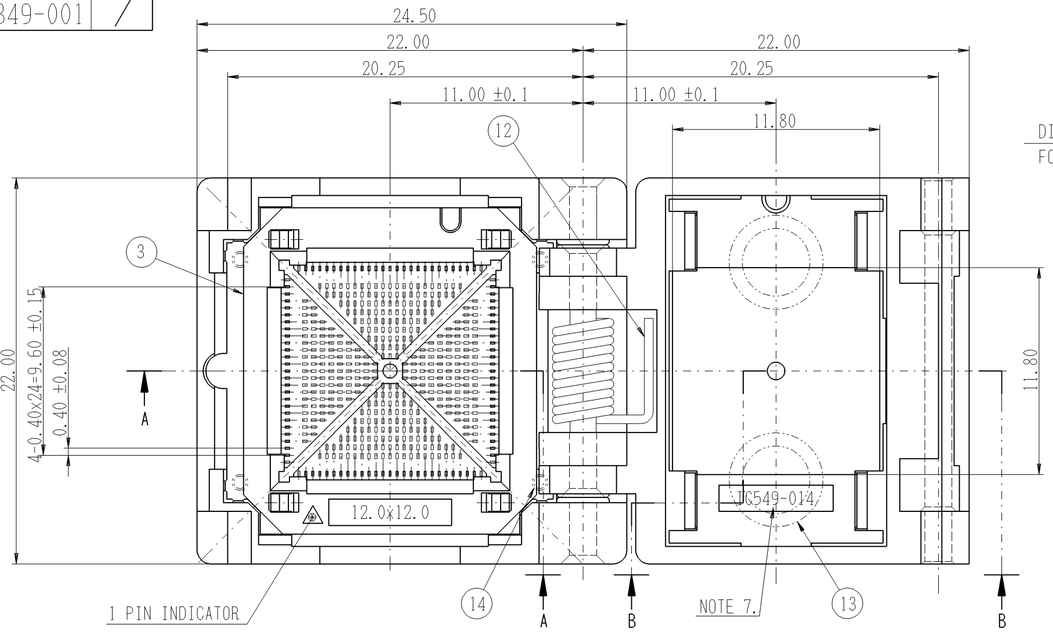
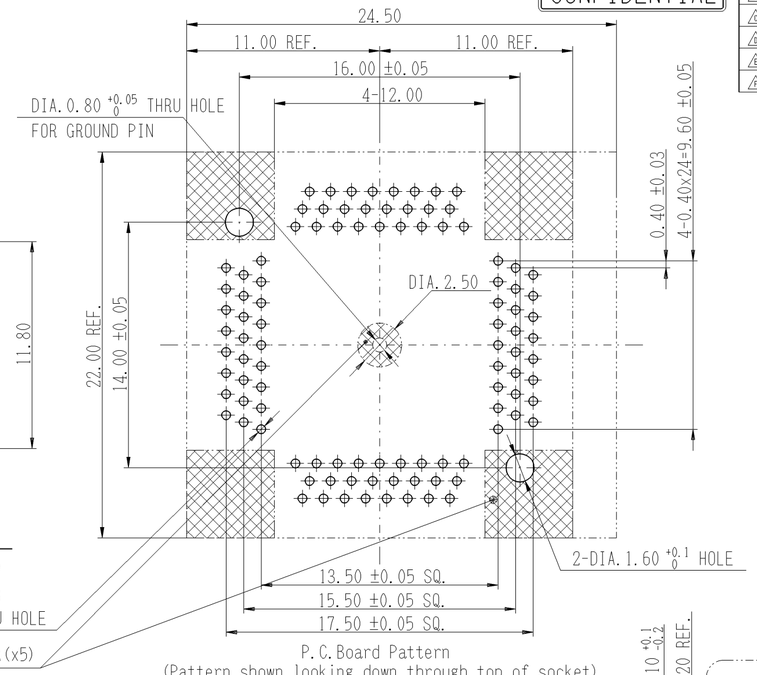
DRW.NO. A118349-001 | Sheet No. 1

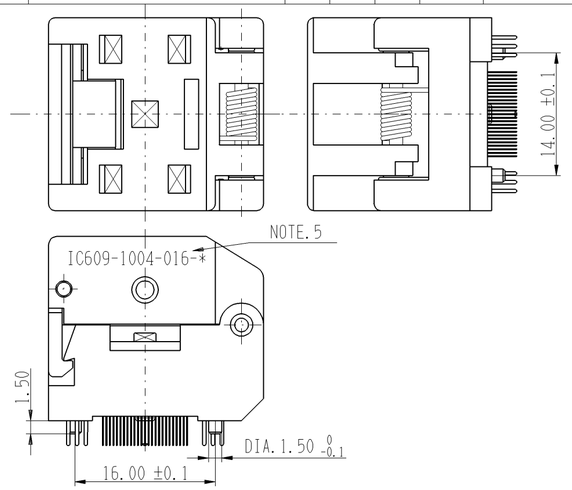
CONFIDENTIAL

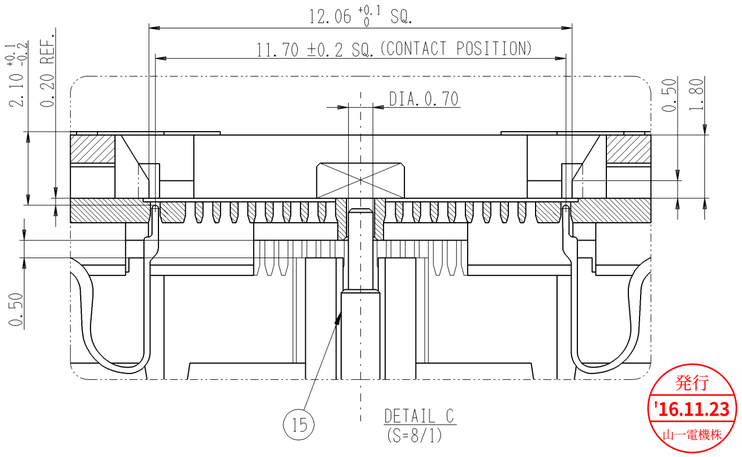
記号×数	変更内容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
6 ×					' . .	
5 ×					' . .	
4 ×					' . .	
3 ×					' . .	
1 ×					' . .	

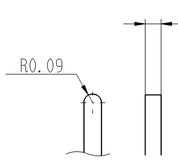




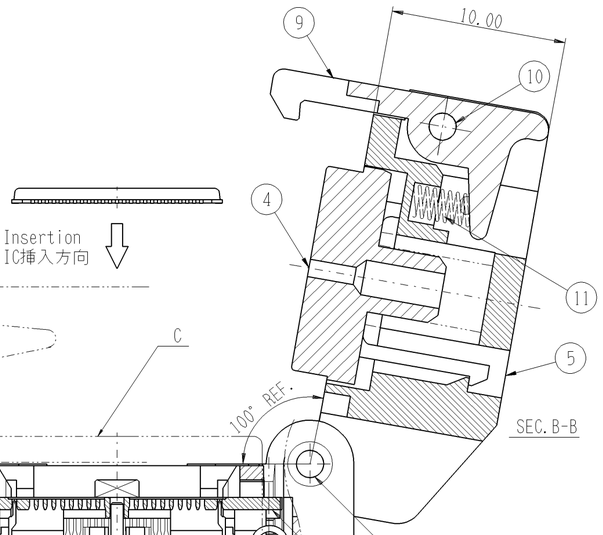
P.C.Board Pattern
(Pattern shown looking down through top of socket)
プリント板寸法図(表面より透視)

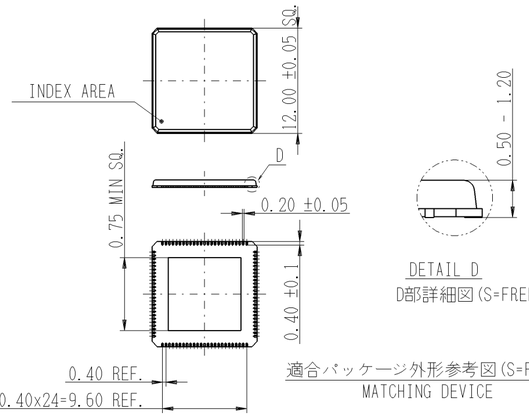






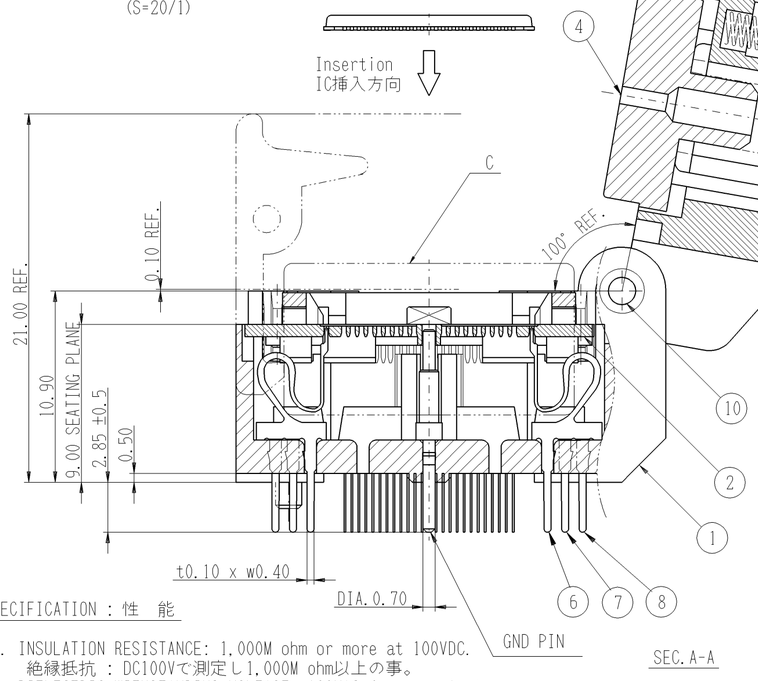
CONTACT TIP DETAIL
(S=20/1)





DETAIL D
D部詳細図(S=FREE)

適合パッケージ外形参考図(S=FREE)
MATCHING DEVICE



発行 '16.11.23 山一電機株

製品名称 TITLE	製品図面番号 IDENT	仕様 SPEC.		グランドピン GROUND PIN	
IC609-1004-016	A118349-002	—	○	無 : Without	
IC609-1004-016-G	A118349-001	○	—	有 : With	
15	CT4310	1	—	BS	Ni-Au PL.
14	CS-627	4	4	SUS	———
13	CS-624	2	2	SUS	———
12	CS-623	1	1	SUS	———
11	CS-628	1	1	SUS	———
10	M-SHAFT-71	2	2	BS DIA.1.50 L=21.50	Ni PL.
9	ST-119	1	1	PEI(GF)	BLACK
8	CT4304-2 -E	32	32	BeCu t0.10	Ni-Au PL.(Class BF)
7	CT4304-2 -C	32	32		
6	CT4304-2 -A	36	36		
5	IC550-0844-001 #PP	1	1	PES(GF)	BLACK
4	IC549-1004-014 #PL	1	1	PEI(GF)	BLACK
3	IC549-1084-007 #GP	1	1	PEI(GF)	BLACK
2	IC549-1084-001 #SD	1	1	PES(GF)	NATURAL
1	IC549-1084-001 #IN	1	1	PES(GF)	BLACK
部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QTY.	個数 QTY.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT

NOTE : 注 記

1. Socket should be held down to the PCB to prevent it from floating during soldering. Center hole on the PCB must be masked to prevent solders from flowing into the center hole.
   半田付けの際には、ソケットベースがPCBより浮き上がらない様にして下さい。
   又、半田上がりが発生しない様、センターホールをマスキング等の処理をして下さい。
2. The package must be inserted into the socket correctly and must be parallel to the seating plane of socket.
   ICがソケットに正しく装着されていること。
3. After solder assembly of socket on the PCB, let the socket cool to room temperature before any washing process.
   洗浄工程に投入の際は、ボード及びソケットが常温になってから実施の事。
4. Keep the PCB trace out of the socket stand-off area to avoid tracecut and socket tilting.
   ソケットスタンドオフエリア内の配線は避けて下さい。
   断線及びソケットの浮き等問題発生の可能性があります。
5. Marking shall be done. Marking is different than socket part number.
   図に示す様に表示する。但し、表示番号と製品名称は異なるので注意のこと。
6. Insertion force should be less than 0.980N(100gf)/pin when using adaptor socket.
   アダプターソケット使用の際は、挿入力0.980N(100gf)/pin以下のこと。
7. This part number and part number on drawing are different.
   本製品の製品名称と彫刻文字は異なる。

SPECIFICATION : 性 能

1. INSULATION RESISTANCE: 1,000M ohm or more at 100VDC.
   絶縁抵抗 : DC100Vで測定し1,000M ohm以上の事。
2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100VAC for one minute.
   耐 電 圧 : AC100Vを1分間印加して異常の無い事。
3. CONTACT RESISTANCE: 100m ohm or less with current and voltage lower than 10mA, 20mV.(initial)
   接触抵抗 : 測定電流10mA、開放端電圧20mV以下で測定し、100m ohm以下のこと。(初期値)
4. OPERATION TEMPERATURE: -40 Deg.C - +150 Deg.C
   使用温度 : -40 Deg.C - +150 Deg.C
5. CONTACT FORCE: 0.343N(35gf)/pin (approx.)
   接 触 力 : 1ピンあたり約0.343N(35gf)。

指定外寸法公差 TOLERANCES ±0.30
Unless Otherwise Specified

山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

尺度 SCALE	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
4/1					
単位 mm DIMENSION	' . .	'16•11•16	'16•11•16	'16•11•16	'16•11•16
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION		Katsunori Takahashi	Arjay Carranza	Robin Ludovice	Robin Ludovice

分類 (CLASS): QFN-p0.40-100P(12.0x12.0 Body)

名称 (TITLE): IC609-1004-016-*

図番 (DRW.NO.): A118349-001 | Sheet No. 1 | REV. A

A2-ED006-13-10